

## Wechselwirkungen zwischen Metallisierungsmaske und Elektrolyt bei der selektiven außenstromlosen Goldabscheidung auf Leiterplatten



Bewertung: Noch nicht bewertet

### Preis

ermäßigter Preis 2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

**Beschreibung 1** Einleitung Eine Vielzahl von Anwendungen in der Leiterplattenfertigung ist mit galvanischen Verfahren nicht zu realisieren, weswegen stromlose Abscheidungsverfahren an Bedeutung zunehmen. Die Selektivität des Verfahrens, die in erster Linie aus Kostengründen angestrebt wird, bedingt den Einsatz entsprechender Metallisierungsmasken. Zur stromlosen Selektivvergoldung von Kupferleiterbahnen (Drahtbondinseln usw.) sind in Abhängigkeit vom verwendeten Maskenmaterial zwei prinzipielle Varianten zu unterscheiden (Abb. 1). Die Verwendung einer temporären Maske ist dabei nur bei verhältnismäßig geringer Cu-Dicke möglich. Jedoch werden aus technologischer Sicht Lötstoppresisten die am häufigsten verwendeten Masken darstellen. Galvanoresisten bilden also nur einen Randbereich für spezielle Anwendungen. NiP dient in beiden Fällen als Diffusionsbarriere gegenüber Kupfer.